公司代码：688525　　公司简称：佰维存储

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、2024年年度报告摘要来自2024年年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2024年年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	佰维存储	688525	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄炎烽	李帅铎
联系地址	广东省深圳市南山区众冠红花岭工业区2区4栋3楼	广东省深圳市南山区众冠红花岭工业区2区4栋3楼
电话	0755-27615701	0755-27615701
传真	0755-26715701	0755-26715701
电子信箱	ir@biwin.com.cn	ir@biwin.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务

公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品及服务为半导体存储器和先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。公司以“存储赋能万物智联（Storage Empowers Everything）”为使命，致力于成为全球一流的存储与先进封测厂商。公司紧紧围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，布局存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节，是国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业。公司产品可广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。

2、主要产品或服务

万物互联时代，数据呈指数级增长，海量数据需要存储，存储形式也更加多元化。公司紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务，主要产品及服务为半导体存储器和先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。

佰维六大产品线

嵌入式存储
eMCP、eMCP、eMMC、UFS、BGA SSD、LPDDR等。
PC存储
固态硬盘、内存条产品
工车规存储
固态硬盘、内存条产品、工业级、车规级等。
企业级存储
固态硬盘SATA/PCIe SSD、RDIMM/RDCIMM内存产品。
移动存储
移动闪存、移动卡产品
先进封测服务
晶圆级先进封测：晶圆级扇出型（FO）、晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）、晶圆级芯片级封装（WLP）、晶圆级系统封装（WLSiP）、晶圆级堆叠（WLS）、晶圆级无源器件集成（IPD）、晶圆级天线封装（WLAP）、晶圆级微机电系统（WLMEMS）、晶圆级光学（WLO）、晶圆级微流控（WLM）、晶圆级生物芯片（WLB）、晶圆级电磁屏蔽（WLEMI）、晶圆级热管（WLHP）、晶圆级天线阵列（WLAA）、晶圆级电源（WLP）、晶圆级能量收集（WLEH）、晶圆级传感器（WLS）、晶圆级冷却（WLC）、晶圆级互连（WLI）、晶圆级封装测试（WLT）、晶圆级可靠性测试（WLR）、晶圆级测试（WLT）、晶圆级光刻（WLL）、晶圆级清洗（WLC）、晶圆级电镀（WLP）、晶圆级检测（WLI）、晶圆级测量（WLM）、晶圆级分选（WLS）、晶圆级包装（WLP）、晶圆级标记（WLM）、晶圆级运输（WLT）、晶圆级存储（WLS）、晶圆级回收（WLR）、晶圆级再生（WLR）、晶圆级废弃（WLD）、晶圆级销毁（WLD）、晶圆级报废（WLD